

立即发布

投资者关系：

Ed Lockwood

投资者关系高级总监

(408) 875-9529

ed.lockwood@kla-tencor.com

媒体关系：

Meggan Powers

企业宣传高级总监

(408) 875-8733

meggan.powers@kla-tencor.com

**KLA-TENCOR™ 与 TEL 宣布推出具有**

**下一代建模功能的 ACUSHAPE™2**

**新型 SPECTRASHAPE™ 尺寸度量系统**

*用于高性能集成电路之复杂几何结构的  
特征描述与生产监测*

【加州 MILPITAS 2011 年 3 月 28 日讯】今天，[KLA-Tencor Corporation™ \(NASDAQ: KLAC\)](#) 宣布推出采用与 [Tokyo Electron Limited \(TEL\)](#) 联合开发之 AcuShape™2 建模软件的 SpectraShape™ 8660 和 8810 尺寸度量系统。新的 SpectraShape 工具能够完整描述集成电路 (IC) 上复杂部件的三维形状特征——并以生产速度监测这些形状。这些新工具的优异性能非常有助于工程师处理复杂的结构，例如高介电常数金属栅极（亚纳米级的外形变动就可能对晶体管的性能产生显著的影响）或双镶嵌接触孔（底径的微小改动就可能严重影响装置的成品率或可靠性）。

尽管面临巨大的工艺控制挑战，IC 制造商们还是已经开始采用复杂的几何结构，以便从每平方厘米的硅晶片上获取更多的性能。对于这些结构，关键尺寸扫描电子显微镜 (CD-SEM) 所提供的顶视图可能并不足以确保制造出的结构符合规格。KLA-Tencor 的新型 SpectraShape 系统采用多种光学技术对这些结构进行全面快速的特征描述。专利算法将多种信号进行合并

与分析，以生成对 IC 部件形状的详细描述，并识别任何超出允许容差的偏差。采用多通道设计的 SpectraShape 8660 和 8810 系统广泛适用于 IC 晶片厂中从早期的尖端晶体管层到最后的互联层的各个环节。

KLA-Tencor 薄膜与散射测量技术 (Films and Scatterometry Technologies, FaST) 部副总裁兼总经理 Ahmad Khan 表示：“将复杂形状引入电路设计中的挑战之一就是会增加因微小工艺偏差而影响装置性能的可能性。我们的工程师设计的这些新型 SpectraShape 系统具备优异的灵活性、精确性和可重复性，能够满足我们客户的下一代形状度量要求。”

光学尺寸度量要求有高级的数学建模方法来解读硬件所发出的信号，而新的 AcuShape2 软件为 KLA-Tencor 的独立度量系统及 TEL 的集成度量 (IM) 系统简化了建模工艺。Timbre Technologies (TEL 的全资子公司，也是 KLA-Tencor 为新型 SpectraShape 系统开发 3D 建模软件的合作伙伴) 的 Jim Hamajima 表示：“新的 AcuShape2 软件包可以提高建立强大可用之 3D 形状模型的速度。同时，我们的用户界面让晶片厂的工程师们能够自行建模，从而避免将其专有的 IC 结构细节泄露给外界。”

采用 AcuShape2 的 SpectraShape 8660 和 8810 的众多功能具有以下特点：

- 功能完备且高度灵活的硬件，具备综合多渠道信号来描述高度复杂的 IC 结构之特征的专利功能
- 新的建模用户界面，专为晶片厂工程师在有或没有外部专家协助的情况下使用而设计
- 与之前各代的 KLA-Tencor 光学 CD 工具相比，建模速度更快、度量时间更短

SpectraShape 8810 与 8660 的差别是增加了一个改善对于高级材料之灵敏度的深紫外 (DUV) 光照选项。

采用 AcuShape2 软件的新型 SpectraShape 尺寸度量系统已经发货给美国和亚洲的多家尖端半导体工厂。为了维持高性能和高产能，SpectraShape 工具由 [KLA-Tencor 的全球综合服务网络](#) 提供支持，且可以连接 [KlearPoint™](#) ( 利用 KLA-Tencor 专家通过实时工具监控来主动管理工具性能的一种新型服务模式 )。关于 KLA-Tencor 尺寸度量系统的更多信息，请访问产品网页：<http://www.kla-tencor.com/metrology/spectrashape-family.html>。

*AcuShape 商标属于 TEL 所有并由 KLA-Tencor 获得使用许可。*

#### **关于 Timbre Technologies：**

Timbre Technologies 是光学度量用散射技术解决方案的业内领先提供商，是 Tokyo Electron Limited 的全资子公司。

#### **关于 TEL：**

Tokyo Electron Limited 成立于 1963 年，是全球创新型半导体与 FPD ( 平板显示器 ) 生产设备的领先供应商。在日本，TEL 还经销全球领先供应商的计算机网络相关产品与电子零部件。为了支持这种多元化的产品经营范围，TEL 的经营机构遍布全球。TEL 是一家在东京股票交易所 (Tokyo Stock Exchange) 挂牌的公开上市公司。<http://www.tel.com/eng>

#### **关于 KLA-Tencor：**

KLA-Tencor 公司 ( 纳斯达克股票代码：KLAC ) 是工艺控制与成品率管理解决方案的领先提供商，它与全球客户合作，开发先进的检测与度量技术。这些技术为半导体、数据存储、LED、光伏及其他相关纳米电子产业提供服务。公司拥有广泛的业界标准产品系列及世界一流的工程师与科学家团队，三十余年来为客户努力打造优秀的解决方案。KLA-Tencor 的总部

设在美国加利福尼亚州 Milpitas，并在全球各地设有专属的客户运营与服务中心。如需更多信息，请访问网站 [www.kla-tencor.com](http://www.kla-tencor.com)。(KLAC-P)

**前瞻性声明：**

本新闻稿中除历史事实以外的声明，例如关于 SpectraShape 8660 和 8810 的预期性能，半导体产业的趋势及其带来的预期挑战，KLA-Tencor 的客户对 SpectraShape 8660 和 8810 的预期使用，以及 SpectraShape 8660 和 8810 工具使用者可以实现的预期成本、运营与其他受益等陈述，均为前瞻性声明，并受到《1995 年美国私人证券诉讼改革法案》(Private Securities Litigation Reform Act of 1995) 规定的“安全港”(Safe Harbor) 条款的制约。这些前瞻性声明基于当前信息及预期，且包含诸多风险与不确定性。由于各种因素，包括延迟采用新技术（无论是由于成本或性能问题抑或其他问题），其他公司推出竞争性产品，或影响 KLA-Tencor 产品的实现、性能或使用的意外技术挑战或限制，因此实际结果可能与此类声明中的预计结果实质不同。

###